



新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

中科院EDA中心参展第九届中国国际半导体博览会

2011-11-07 | 编辑: 七室 刘红婕 | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

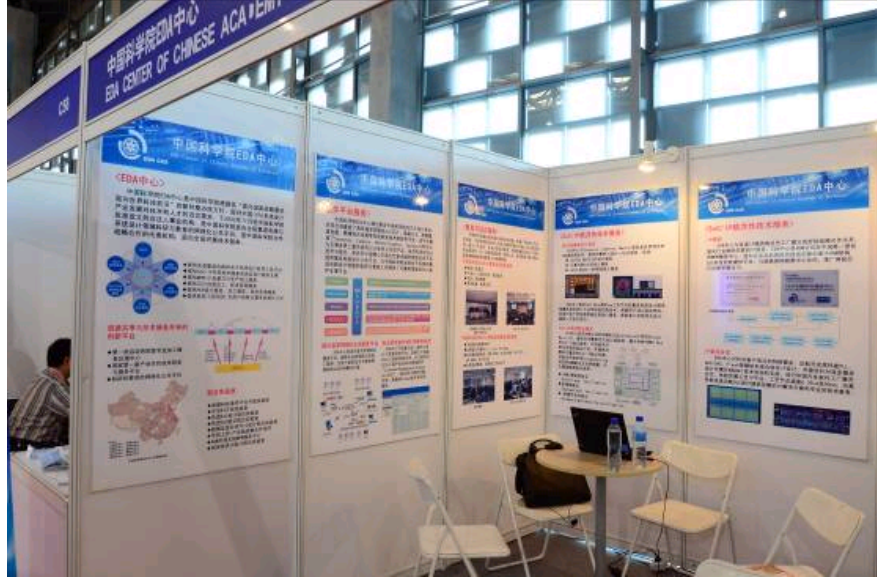
2011年10月26-28日, 中科院EDA中心参加了由中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会、中国半导体行业协会、上海市经济和信息化委员会主办的第九届中国国际半导体博览会, 让更多的产业伙伴了解了EDA中心的资源集成和技术服务能力。

在本届博览会上, EDA中心围绕“夯实核心基础, 服务战略性新兴产业”的展会主题, 展出了其在软件平台、SoC/IP核共性技术、多项目晶圆(MPW)、封装、PCB设计、培训和物联网等方向的服务业务和部分产品, 吸引了众多IC企业代表和相关设计人员前来参观咨询。

同往届博览会相比, EDA中心新增了物联网技术方面的服务业务展示; EDA软件平台方面, 新集成了传感器EDA软件和器件仿真软件工具; 在SoC/IP核共性技术服务方面, 基于与ARM公司的合作, 增加了移动通讯芯片的验证和低功耗技术服务。同时, EDA中心在培训服务方面开设了国产EDA工具专题培训。

作为参展的少数共性技术平台单位之一, EDA中心将继续保持在集成电路与系统设计领域的技术服务优势, 发挥在中国集成电路产业技术发展和整个行业资源整合中的平台作用, 为我国集成电路产业创新价值链的建设做出更大贡献。





展览会现场

附件下载:



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编: 100029

单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号, 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号